8000–12000 MHz QFN封装低噪声放大器芯片

LCI-LNA-8000-12000-NF0p9T-SG28T-M — 8000–12000 MHz QFN封装低噪声放大器芯片.

噪声系数: 0.9 dB (典型值); 小信号增益: 28 dB (典型值); 输出1 dB压缩点功率: 10 dBm (典型值). 封装尺寸: 2.5 × 2.5 × 0.75 mm.



RF 特性

TA = +25 °C; Vd = +5 V; Pin = -35 dBm

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率	-	8000	-	12000	MHz
输出1 dB压缩点功率	-	-	10	-	dBm
小信号增益	-	-	28	-	dB
噪声系数	-	-	0.9	-	dB

直流偏置与电流

TA = +25 °C; Vd = +5 V; Pin = -35 dBm

参数	符号	最小值	典型值	最大值	数值	单位
工作电压	-	-	-	-	5	V
静态工作电流	-	-	0.028	-	-	A

电气特性

参数	符号	最小值	典型值	最大值	数值	单位
封装	-	-	-	-	QFN 2.5 × 2.5	mm
端口数量	-	-	-	-	16	-
RF输入引脚	-	-	-	-	2	-
RF输出引脚	-	-	-	-	11	-
供电引脚	-	-	-	-	7 (Vd = +5 V)	-
接地引脚	-	-	-	-	1, 3, 10, 12	-
悬空引脚	-	-	-	-	4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16	-

极限参数

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
最高工作电压	-	-	-	6	V
最大输入功率	-	-	-	15	dBm
最高回流焊峰值温度	-	-	-	260	°C

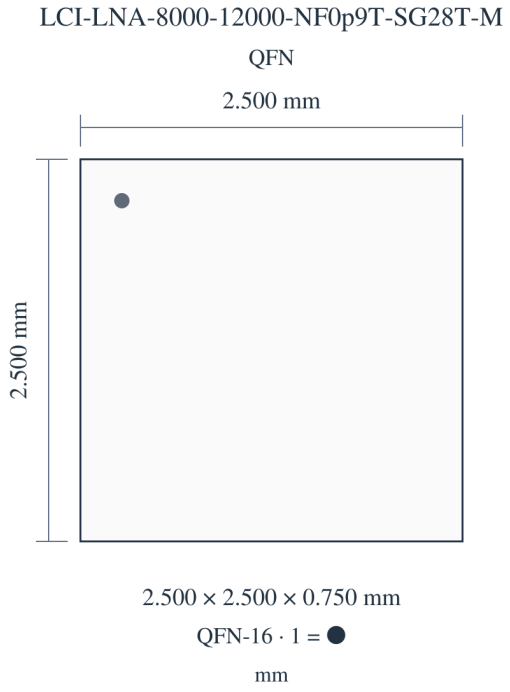
环境参数

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
储存温度	-	-65	-	150	°C
工作温度	-	-55	-	85	°C

封装尺寸

参数	数值	单位
封装尺寸	2.5 × 2.5 × 0.75	mm

封装外形参考图，单位为 mm。图中列出部分尺寸。



当前出版记录 · 1.3 · 2026-11-12. 产品说明或编辑内容更新。 替代版本 1.2.

裸片集成与偏置时序

输入与输出端集成隔直电容。

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。